

半导体前驱体痕量分析用高纯PFA惰性气体吹扫装置，兼容氮气和氩气吹扫系统

货号: PL-CP429

简介

用于半导体前驱体检测与痕量分析的超高纯PFA惰性气体吹扫装置，适配氮气或氩气吹扫，可在关键实验室流程中防止样品氧化与污染，采用耐化学腐蚀结构设计，适用于专业研究场景。

了解更多



应用场景	描述	核心优势
半导体前驱体测试	在ICP-MS分析前，用氩气吹扫有机金属前驱体，防止氧化。	确保ALD/CVD前驱体表征结果准确。
IC制造质量控制	对工艺化学品进行痕量金属分析时的高纯气体吹扫。	消除材料带来的污染，降低检出限。
电池电解质研究	在溶剂萃取和吹扫过程中保护对湿气敏感的锂电池组件。	维持电解质稳定性，保证电化学测试结果一致。
催化剂合成	在从合成到分析的转移过程中，保护对空气敏感的催化剂。	防止催化剂被大气氧气或湿气毒化。
石油化工痕量分析	通过氮气置换从复杂烃基质中脱除挥发性馏分。	对含硫苛刻化合物和溶剂具备优异耐受性。
先进纳米材料制备	在功能化纳米颗粒样品制备过程中维持惰性环境。	保留表面化学特性，防止不必要的表面氧化。
特种气体分析	作为高纯电子气体取样和分析的高纯接口。	避免大气泄漏或材料出气带来的背景噪声。

特性	规格参数 (PL-CP429)
核心材质	超高纯PFA (全氟烷氧基树脂)
制造工艺	CNC精密加工 / 定制制造
标准容量	30ml (可按需定制其他容量)
兼容气体	氮气 (N ₂)、氩气 (Ar)、氦气 (He) 及其他惰性气体
耐化学性	耐受所有常用溶剂、强酸和强碱
温度范围	可根据具体应用的温度要求完全定制
压力等级	针对标准气体吹扫压力优化设计 (支持定制)
连接接口	可适配您现有气路和分析仪器接口定制
清洁方案	兼容酸洗和高纯清洁工艺